

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.7.17

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：XES 衍射弯晶

预算：900000 元

技术要求：

采购 XES 衍射弯晶共 48 块，其中球面弯晶 Si (444)、Si (440)、Si (400)、Si (531)、Si (620) 各 5 块，球面弯晶 Ge (440)、Ge (400)、Ge (620)、Ge (444) 各 5 块，柱面弯晶 Si (444) 3 块，便携式分析晶体面型检测仪 1 台。具体技术参数要求如下：

表 1 球面弯晶技术参数要求

技术参数	
面型	球面弯晶
弯晶尺寸（直径）	100 mm±0.5 mm
曲率半径	500 mm±1%
晶片厚度	300 μm±10 μm
晶向误差	≤0.3 degree
玻璃底座平面度	≤1/4 lambda
晶体底座直径	101.6 mm±0.5 mm
采集 XES 光谱时加工误差带来的能量展宽	≤1.2 eV
表面峰谷差（PV）	≤5 μm
表面粗糙度（RMS）	≤1 μm
附件配置	包含安装支架及基座
支架卡槽尺寸	102 mm±0.5 mm
支架安装调平精度	≤100 μm

表 2 柱面弯晶技术参数要求

技术参数	
面型	柱面弯晶
弯晶尺寸	100 mm±0.5 mm（弯曲方向）
	50 mm±0.5 mm（非弯曲方向）
曲率半径	250 mm±1%
晶片厚度	300 μm±10 μm
晶向误差	≤0.3 degree
玻璃底座平面度	≤1/4 lambda



晶体底座尺寸	101.6 mm±0.5 mm（弯曲方向） 51.6 mm±0.5 mm（非弯曲方向）
采集 XES 光谱时加工误差带来的能量展宽	≤1.2 eV
表面峰谷差（PV）	≤5 μm
表面粗糙度（RMS）	≤1 μm
附件配置	包含安装支架及基座
支架卡槽尺寸	102 mm±0.5 mm（弯曲方向） 52 mm±0.5 mm（非弯曲方向）
支架安装调平精度	≤100 μm

表 3 便携式分析晶体面型检测仪技术参数要求

技术参数	
探头重量	≤400 g
探头测量行程	±15mm（高精度模式）/±35mm（标准模式）
探测分辨率	≤0.25 μm
采样周期	≤100 μs
最大面型测试直径尺寸	≥120 mm

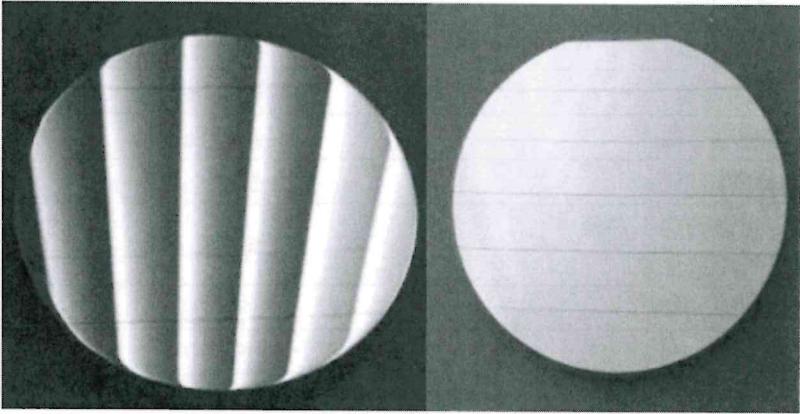


图 1. Ge 晶体

图 2. Si 晶体



备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
标准件需要注明品牌和型号，非标加工件需要注明生产厂商。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

